

2024日本电子展|日本国际电子科技博览会NEPCON JAPAN

产品名称	2024日本电子展 日本国际电子科技博览会NEPCON JAPAN
公司名称	上海福贸展览服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国.上海市.莲花南路1951号格兰大厦403室
联系电话	021-61984439 18516582289

产品详情

日本是一个高度发达的资本主义国家。其资源匮乏并极端依赖进口，发达的制造业是国民经济的主要支柱。科研、航天、制造业、教育水平均居全球前列。此外，以动漫、游戏产业为首的文化产业和发达的旅游业也是其重要象征。据调查，日本在环境保护、资源利用等许多方面堪称世界典范，其国民普遍拥有良好的教育、极高的生活水平和国民素质。日本是电子工业强国，随着近年来人工智能电子工业的不断发展，日本本土的电子制造业呈现出衰退的趋势，由过去的销售快速增长到现在的依赖于电子核心部件、上游化学材料保有优势。在返个过程中，日本市场呈现出新的需求，为中国的整机产品、配套产品制造企业打入日本市场带来了良好的契机，同时也带来了广阔的合作机遇。据日本海关统计，2019年1月，日本与中国双边货物进出口额为764.0亿美元。其中，日本对中国出口340.5亿美元，总额增长14.2%；自中国进口423.5总额增长7.0%。日本与中国的贸易逆差83亿美元。中国是日本第二大出口目的地。

2024日本国际电子科技博览会NEPCON JAPAN

东京开展日期：2025年01月24日-01月26日 展馆名称：日本东京有明国际展览中心 TOKYO BIG SIGHT

名古屋展日期：2023年10月25日-10月27日 展馆名称：日本名古屋国际会展中心Portmesse Nagoya

展会规模：约1200家参展商； 参观人数：约50000名；

主办单位：励展博览集团日本株式会社

组展单位：上海福贸展览服务有限公司--日本展会专门服务商

不参展人员，我司可提供组团观展服务，提供签证，机piao，酒店，入场证办理等服务

另我司可代办日本签证（商务，旅游，三年多次，5年多次）材料简单，出签快

展品范围：SMT 贴片、IC 封装、PCB/PWB、测量/分析、电子元件/材料、精密加工等

展会介绍

作为“电子研发，制造与封装技术”的综合展会，NEPCON JAPAN随着日本及亚洲电子行业的发展不断成长壮大，至今已走过30多个年头。展会由电子产品制造设备及部件技术展，电子零部件检测设备及开发技术展，电子零部件封装设备及开发技术展，印shua电路展，电子元件及材料展，精密加工技术展这6个专门展会组成。是名副其实的“代表亚洲电子产业”的综合性展览会。NEPCON JAPAN作为了解“未来电子产业”领先技术的绝佳场所而备受业界瞩目，吸引越来越多来自全球的参展商与观展人士汇聚一堂！

同期展会

NEPCON JAPAN日本电子科技博览会由六大专门展会组成：

- 1、电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN汇集了各种电子产品制造及SMT所用设备、解决方案、技术及服务。
- 2、电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：亚洲领先的电子研发制造领域有关测试，检查，测量和分析技术的专门展会。
- 3、电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXP亚洲领门的集成电路制造展！汇集了各种先进的设备、材料及服务。
- 4、电子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO亚洲领先！汇集各种电子元件和材料
- 5、印shua电路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo装配设备、保证材料/组件、IC封装汇集了如PCB材料，设计开发委托服务与设计工具软件等各种PCBs/PWBs及技术。
- 6、精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO电子制造领域精密加工技术专门展！诸如模具制造、切削、冲压加工、蚀刻等各种精密·微细加工技术汇聚一堂！